



For All Sputtering Process Product  
**ARC Coating**

PVD 공정 중 챔버의 내벽으로 분산되는 스퍼터링 입자(박막물질)의 증착력을 높여 이들이 비(非)정상적으로 박리(剝離)되는 것을 억제할 수 있는 표면 구조를 갖도록 형성하는 것이 매우 중요합니다. Chamber 내벽에 형성된 표면 구조에서의 증착 입자의 비정상 박리 억제를 통해 스퍼터링 시 기판의 일면에 증착되어 형성되는 박막 측 오염 및 불량을 방지할 수 있습니다.

## Mechanism

### ARC Coating은,

두 개의 Metal Wire를 전극으로 사용하여 서로 다른 전압을 인가, 2개의 Wire가 교차하는 지점에서 ARC 발생에 의한 Wire 용융과 동시에 압축 공기를 분사하여 용융된 Metal을 기판에 융착해 Coating Layer를 형성하는 기술입니다.

## Benefit

ARC Coating은 Sputtering PVD Chamber 내부의 외벽에 거칠기를 형성하여 Sputtering 증착물이 Chamber Wall에서 박리되는 현상을 억제하여 Parts의 사용 주기를 연장시켜 줍니다. 또한, ARC Coating은 ARC에 의해 용융된 Wire를 압축공기로 분사하기 때문에 분사 조건을 달리 하면 다양한 형태의 Roughness를 형성할 수 있으며 CINOS에서는 **600, 900, 1200  $\mu$ inch 등 다양한 Roughness의 Metal Coating을 제공할 수 있습니다.**

## Application

For  
반도체  
Sputtering  
공정 부품

